

CLAIMS AMENDMENTS

1. (Currently Amended) Verfahren zum Herstellen eines Bandes, welches eine durch seine zwei Längsränder bestimmte Breite hat, aus mindestens einem ersten metallischen oder überwiegend metallischen Werkstoff zusammengesetzt ist and der Bereich des Bandes, über den sich der erste Werkstoff erstreckt, eine Grenzfläche ~~(38a, 38b, 38c)~~ aufweist, welche im Querschnitt des Bandes stufenförmig zwischen den beiden. Längsrändern ~~(36, 37)~~ des Bandes verläuft, **dadurch gekennzeichnet, dass**
 - (a) unterschiedlich breite Bänder ~~(31, 32, 34)~~, welche den ersten Werkstoff enthalten und welche selbst keine stufenförmige Grenzfläche zwischen ihren beiden Längsrändern haben, zu einer ersten Bänderanordnung mit einer stufenförmigen Grenzfläche zusammengeführt werden,
 - (b) dass die erste Bänderanordnung durch eines oder mehrere weitere Bänder ~~(33, 35)~~ zu einer im Querschnitt rechteckigen zweiten Bänderanordnung ergänzt wird und
 - (c) durch Walzen der zweiten Bänderanordnung wenigstens die Bänder ~~(31, 32, 34)~~ der ersten Bänderanordnung miteinander verbunden werden.
2. (Original) Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schritte (a) und (b) gleichzeitig durchgeführt werden.
3. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 1 ~~oder 2~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass für das Walzen zwei zylindrische Arbeitswalzen ~~(2, 3)~~ verwendet werden, welche einen Walzspalt begrenzen, und dass die einzelnen Bänder ~~(31 bis 35)~~, aus denen die zweite Bänderanordnung gebildet wird, erst im Walzspalt oder kurz vor dem Walzspalt zusammengeführt werden.
4. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 1 ~~bis 3~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Walzen als Kaltwalzplattieren durchgeführt wird.
5. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 1 ~~bis 3~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Walzen als Warmwalzplattieren durchgeführt wird.

6. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 4 ~~oder 5~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Band nach dem Walzplattieren durch einen weiteren Walzvorgang egalisiert wird.
7. (Original) Verfahren nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Band erst nach dem Egalisieren aufgewickelt wird.
8. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 6 ~~oder 7~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Band zwischen zwei den Arbeitswalzen ~~(2, 3)~~ nachgeordneten Egalisierwalzen ~~(14)~~ egalisiert wird.
9. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der vorstehenden Ansprüche~~ Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwischen den Bändern ~~(31, 32, 34)~~ der ersten Bänderanordnung, soweit sie sich nicht unmittelbar durch Walzen miteinander verbinden lassen, eine die Bindung vermittelnde Zwischenschicht angeordnet wird.
10. (Original) Verfahren nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass zur Bildung der Zwischenschicht ein gesondertes Band in die erste Bänderanordnung eingeführt wird.
11. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Zwischenschicht auf eines oder mehrere der Bänder ~~(32, 34)~~, welche die erste Bänderanordnung bilden, plattiert wird, bevor diese zur ersten Bänderanordnung zusammengeführt werden.
12. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Zwischenschicht auf eines oder mehrere der Bänder ~~(32, 34)~~, welche die erste Bänderanordnung bilden, galvanisch abgeschieden wird.
13. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 9 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Zwischenschicht dünner gewähit wird als die Bänder ~~(31, 32, 34)~~, welche sie verbinden soll.
14. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 9 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Zwischenschicht sehr viel dünner gewähit wird als die Bänder ~~(31, 32, 34)~~, welche sie verbinden soll.

15. (Original) Verfahren nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass das die Zwischenschicht höchstens 10 µm dick abgeschieden wird.
16. (Original) Verfahren nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Zwischenschicht höchstens 5 µm dick abgeschieden wird.
17. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der vorstehenden Ansprüche~~ Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Werkstoff eines, mehrerer oder aller weiteren Bänder ~~(26, 30, 33, 35)~~, weiche die erste Bänderanordnung zu der zweiten Bänderanordnung ergänzen, so gewählt ist, dass er sich nicht oder nur wesentlich schwächer als es die Bänder ~~(31, 32, 34)~~ der ersten Bänderanordnung tun, durch das Walzen mit den Bändern der ersten Bänderanordnung verbindet und dass diese weiteren Bänder ~~(26, 30, 33, 35)~~, deren Werkstoff in der genannten Weise gewählt ist, nach dem Walzen der zweiten Bänderanordnung aus dieser wieder entfernt werden.
18. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass hinter dem Walzspalt die zu entfernenden weiteren Bänder ~~(26, 30, 33, 35)~~ in eine andere Richtung gezogen werden als das durch das Walzplattieren fester zusammenhängende und die erste Bänderanordnung enthaltende zusammengesetzte Band, welches herzustellen war, und dass die zu entfernenden weiteren Bänder ~~(26, 30, 33, 35)~~ auf diese Weise aus der gewalzten zweiten Bänderanordnung entfernt werden.
19. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass an der Stelle ~~(A, B)~~, an welcher sich die zu entfernenden weiteren Bänder ~~(26, 30)~~ von dem zusammengesetzten, fester zusammenhängenden Band ~~(28)~~ trennen, zwischen diesem zusammengesetzten Band ~~(28)~~ and dem einen oder den mehreren zu entfernenden weiteren Bändern ~~(26, 30)~~ Führungsflächen vorgesehen sind, weiche eine Führung der Bänder in die jeweilige Zugrichtung unterstützen.
20. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Führungsflächen einen oder mehrere Keile ~~(80)~~ bilden.

21. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 6 bis 8 in ~~Verbindung mit einem der Ansprüche 17 bis 20~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Egalisieren durchgeführt wird, nachdem wenigstens eines der weiteren Bänder ~~(26)~~ von der gewalzten zweiten Bänderanordnung entfernt worden ist.
22. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 6 bis 8 in ~~Verbindung mit einem der Ansprüche 17 bis 20~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Egalisieren durchgeführt wird, nachdem alle weiteren Bänder von der gewalzten zweiten Bänderanordnung entfernt worden sind.
23. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 1 bis 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Werkstoff des oder der weiteren Bänder ~~(33, 35)~~ verschieden von dem ersten Werkstoff gewählt ist und alle Bänder ~~(31 bis 35)~~ der zweiten Bänderanordnung durch das Walzen miteinander verbunden werden.
24. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der vorstehenden Ansprüche~~ Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass Bänder verwendet werden, die, abgesehen von einer aufplattierten, verglichen mit der Dicke des betreffenden Bandes dünnen und beim Walzen die Bindung herstellenden Schicht, vollständig aus nur einem Werkstoff bestehen.
25. (Original) Verfahren nach Anspruch 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass Bänder aus einem homogenen Werkstoff verwendet werden.
26. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der vorstehenden Ansprüche~~ Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Band nach dem Walzen einer Wärmebehandlung unterzogen wird.
27. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der vorstehenden Ansprüche~~ Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die erste Bänderanordnung wenigstens zwei Bänder ~~(44, 46; 45, 46)~~ hat, welche nebeneinander und parallel zueinander so angeordnet sind, dass sich ihre einander zugewandten Flanken berühren, dass die stoffliche Beschaffenheit der miteinander zu verbindenden Flanken so festgelegt wird, dass sie sich durch Erhitzen der einander berührenden Flanken stoffschlüssig miteinander verbinden lassen, und dass die wenigstens zwei Bänder ~~(44, 46; 45, 46)~~ wenigstens im Bereich ihrer

einander berührenden Flanken auf eine solche Temperatur erhitzt werden, bei welcher sich diese Flanken dann unmittelbar stoffschlüssig miteinander verbinden.

28. (Original) Verfahren nach Anspruch 27, **dadurch gekennzeichnet**, dass die zweite Bänderanordnung beim Walzen so geführt wird, dass ihre Bänder im Walzspalt nicht zur Seite hin ausweichen können.
29. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 27 ~~oder 28~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass die stoffliche Beschaffenheit der miteinander zu verbindenden Flanken unterschiedlich so gewählt wird, dass sich beim Erhitzen der einander berührenden Flanken eine Legierung bildet, deren Schmelzpunkt niedriger ist als der Schmelzpunkt der paarweise an den Flanken miteinander zu verbindenden Bänder ~~(44, 46; 45, 46)~~.
30. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 27 ~~oder 28~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass wenigstens eines der paarweise an den Flanken miteinander zu verbindenden Bänder ~~(44, 46; 45, 46)~~ wenigstens an der betreffenden Flanke mit einem Lot beschichtet wird.
31. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 30, **dadurch gekennzeichnet**, dass das wenigstens eine der beiden Bänder ~~(44, 46; 45, 46)~~ nur an der betreffenden Flanke mit dem Lot beschichtet wird.
32. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 30 ~~oder 31~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass das wenigstens eine Band ~~(44, 45)~~ an seiner betreffenden Flanke mit einem ersten Metall und das andere Band ~~(46)~~ an seiner betreffenden Flanke mit einem zweiten Metall beschichtet wird und diese Metalle infolge des Erhitzens die niedriger schmelzende Legierung bilden.
33. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 30 bis 32, **dadurch gekennzeichnet**, dass die betreffende Flanke durch ein galvanisches Verfahren beschichtet wird.
34. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 27 bis 34, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Bänder ~~(44, 46; 45, 46)~~ im Walzspalt mit ihren einander zugewandten Flanken gegeneinander gedrückt werden.

35. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der vorstehenden Ansprüche~~ Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass mit einer Stichabnahme von mindestens 50 % gewalzt wird.
36. (Original) Verfahren nach Anspruch 35, **dadurch gekennzeichnet**, dass mit einer Stichabnahme von 60 % bis 80 % gewalzt wird.
37. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 26 bis 34, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Bänder ~~{44, 46; 45, 46}~~ bzw. die erste oder zweite Bänderanordnung nach dem Walzen auf die Temperatur erhitzt werden, bei welcher sich die Flanken stoffschlüssig miteinander verbinden.
38. (Original) Verfahren nach Anspruch 37, **dadurch gekennzeichnet**, dass die erste Bänderanordnung nach dem Walzen zusammenhängend aufgewickelt und danach erhitzt wird.
39. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 37, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Bänder ~~{44, 46; 45, 46}~~ bzw. die erste oder zweite Bänderanordnung sofort nach dem Walzen erhitzt werden.
40. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 39, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Bänder ~~{44, 46; 45, 46}~~ bzw. die erste oder zweite Bänderanordnung mit der Geschwindigkeit, mit welcher sie den Walzspalt verlassen, eine Heizzone durchlaufen.
41. (Currently Amended) Verfahren nach ~~einem der Ansprüche~~ Anspruch 27 bis 34, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Bänder ~~{44, 46; 45, 46}~~ in der ersten oder zweiten Bänderanordnung vor dem Walzen auf die Temperatur erhitzt werden, bei welcher sich die Flanken stoffschlüssig miteinander verbinden.
42. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 41, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Bänder ~~{44, 46; 45, 46}~~ in der zweiten Bänderanordnung unmittelbar vor dem Walzen erhitzt und dann heiß gewalzt werden.

43. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 41 ~~oder 42~~, **dadurch gekennzeichnet**, dass die erste und die zweite Bänderanordnung schon in der Zone, wo sie erhitzt werden, so geführt werden, dass ihre Bänder nicht zur Seite hin ausweichen können.
44. (Currently Amended) Verfahren nach Anspruch 1, ~~in welchem eines oder mehrere der nach einem der Ansprüche 1 bis 25 hergestellten Bänder erneut in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 25 zur Herstellung eines komplexeren Bandes eingesetzt werden.~~